

# グラビアオフセット印刷用 導電性銅ナノインク

Conductive Cu Nano Ink for Gravure offset printing

## 特長 Features

- 1 純銅に近い比抵抗の皮膜が得られます。  
The resistivity of Cu film is close to that of bulk copper.
- 2 PET、PEN、PC、PI、ガラス等の基材上で回路形成が可能です。  
Minute Cu circuit patterns can be formed on polyimide(PI), glass, silicon substrates, and PET with the Cu nano ink.
- 3 線幅の異なる配線の同時印刷が可能です。  
The Conductive Cu Ink can be printed patterns of different line width simultaneously.

## インク特性 Properties of ink

型番	Applicable substrate	GO-01 太線用 (>20 $\mu$ m)	GO-03A 細線用 (<10 $\mu$ m)
Cu濃度 (mass%)	Cu content	65 - 75	75 - 85
平均粒径 (nm)	M.D.	<70	<70
粘度 (mPa $\cdot$ s)	Viscosity	1000 - 6000	1000 - 6000
体積抵抗率 ( $\mu\Omega\cdot$ cm)	Resistivity	・9-10 (vs. PI and glass) キセノンフラッシュランプによる焼成 Sintering by Xenon flash lamp	・9-10 (vs. PI and glass) キセノンフラッシュランプによる焼成 Sintering by Xenon flash lamp
密着性	Adhesion	テープ剥離無し (vs. PI and glass) No peeling vs. PI and glass	テープ剥離無し (vs. PET) No peeling vs. PET

## グラビアオフセット印刷 Gravure offset printing



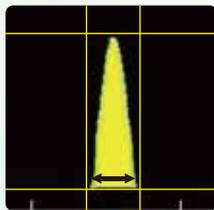
L/S=10/50  $\mu$ m

Hard coat PET上の銅回路と配線形

Cu circuit pattern on HCPET and line profile

膜厚 Thickness of the film : 1.6  $\mu$ m

線幅 Line width : 12  $\mu$ m



10  $\mu$ m



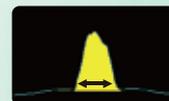
7  $\mu$ m

Hard coat PET上の銅メタルメッシュ

Cu metal mesh on HCPET

膜厚 Thickness of the film : 0.7  $\mu$ m

線幅 Line width : 7  $\mu$ m



7  $\mu$ m

本資料に記載する数値は当社の試験に基づく実測値であり、保証値ではありません。  
We do not give any guarantee concerning technical values on this catalog.

